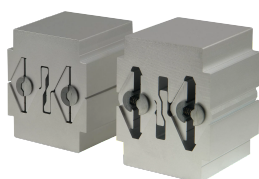


Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 70 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-ipcprocessors and AMD processors with the following sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366,LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Compatible with Interscale C enclosures

Provides industry leading conduction cooling performance, 70% improvement over current conduction cooling methods

Conductor block expands/contracts vertically to compensate fortolerance stack up and optimizes surface contact and pressurealong the thermal path; eliminates the need for a thermal gappad

Secured to PCB with mounting brackets, sold separately

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Typ	Works With	Množství v balení	Hloubka	Šířka
------------------	-----	------------	-------------------	---------	-------

24830-001	Heat Conductor	Cases	1	50 mm	50 mm
-----------	----------------	-------	---	-------	-------

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order the mounting bracket (Intel or AMD, listed under accessories) to assemble the FHC to the board.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte